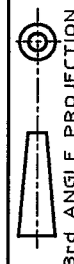


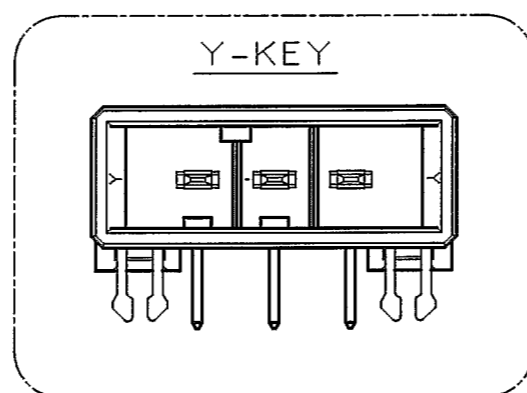
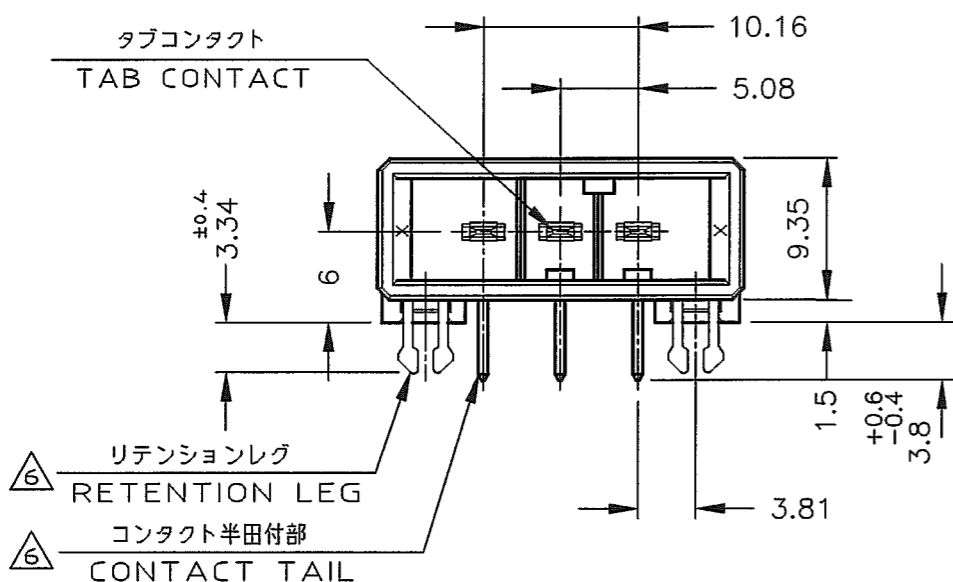
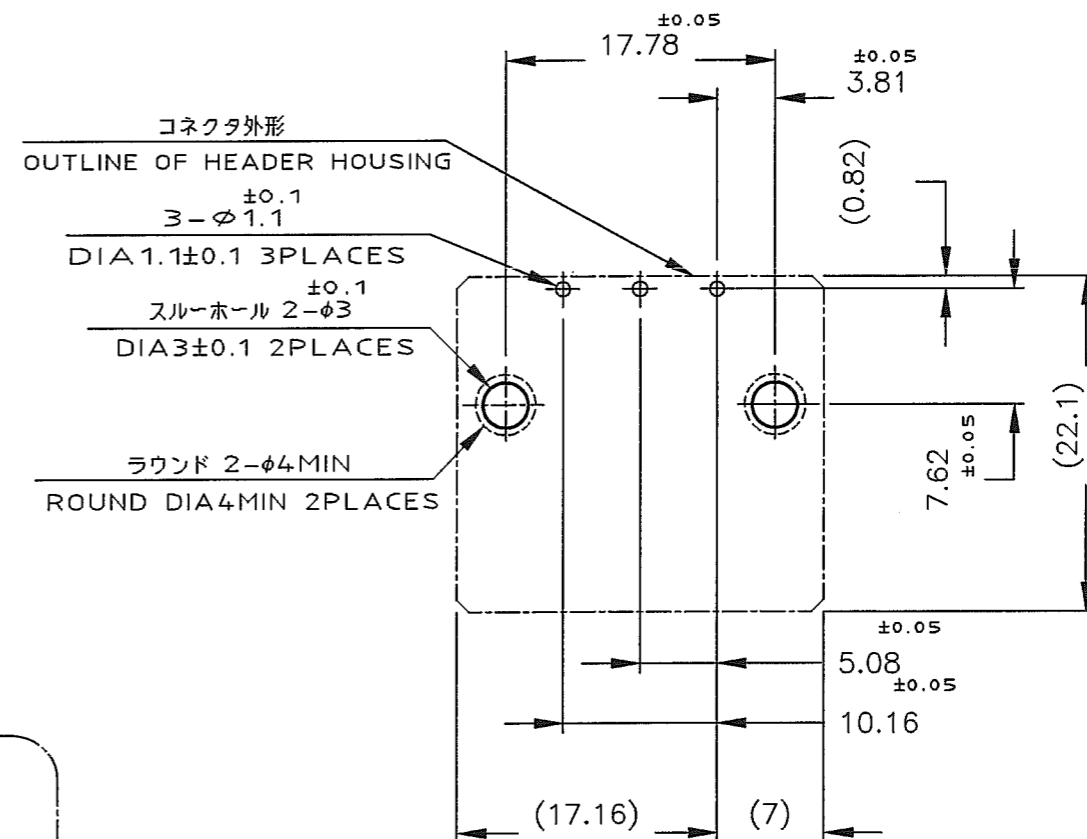
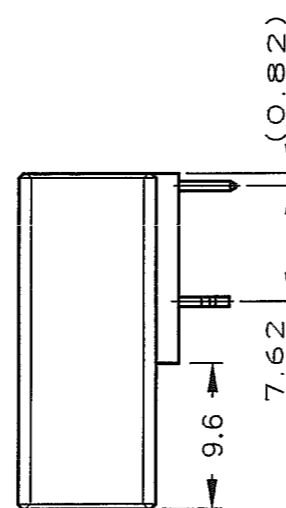
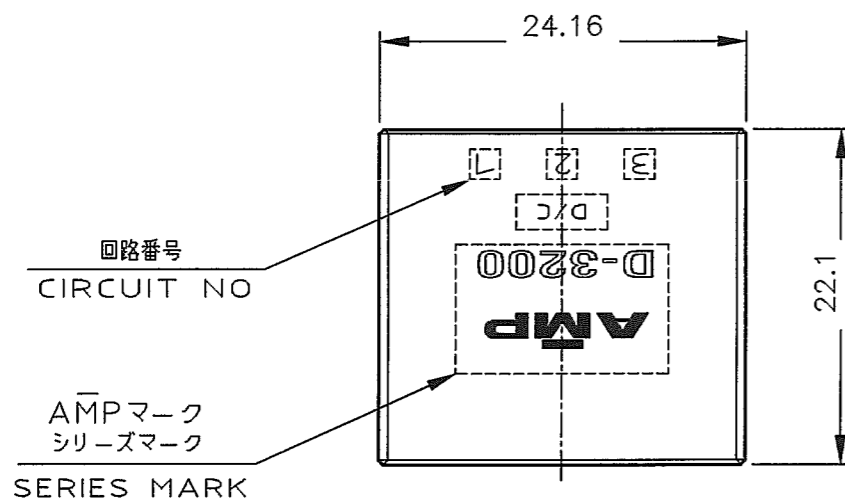
NUMBER 178138



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法  
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の上に半田めっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	2-178138-5	Y
△6	△3	2-178138-3	Y
△6	△2	2-178138-2	Y
△6	△4	1-178138-5	X
△6	△3	1-178138-3	X
△6	△2	1-178138-2	X
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)	KEY

WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME	
mm <sup>2</sup> (AWG - )		mmφ	3 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
DR. 20/MAR/95 K.IKEDA		DE. 20/MAR/95 K.IKEDA	100F : ±0.3	A3 J C-178138
CHK. 23/MAR/95 S.MANABE		APP. 23/MAR/95 S.MANABE	100F 300F : ±0.4	SCALE REV. SHEET
E1 REVISED PER ECO-11-005030		RK HMR 23/MAR/11	300F 1000F : ±0.5	2-1 E1 1 OF 1
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE	角 度 : ±3'	

E1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23/MAR/11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)